股票代码:002185 股票简称:华天科技 上市地点:深圳证券交易所 公告编号:2025-050

华天科技 HT-Tech

# 天水华天科技股份有限公司
# 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

| 交易类型 | 交易对方名称 |
|---|---|
| 发行股份及支付现金购买资产 | 天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方 |
| 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 |

## 签署日期:二〇二五年十月

### 声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次交易过程中所提供的资料与信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如果违反上述承诺,愿意承担相应法律责任。

本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺:如果承诺方就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,承诺方同意不转让在上市公司拥有权益的股份,并将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代承诺方向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如果承诺方未在两个交易日内提交前述锁定申请的,承诺方在此同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定;如果上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息,承诺方在此同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如果调查结论发现存在违法违规情节,承诺方承诺自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过审计机构的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证,也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、证券交易所的审核通过、中国证监会的注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后,本公司经营与收益变化由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时,除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函:

1、本企业为本次交易所提供的资料与信息(无论该等资料、信息提供的对象、场合、内容或方式如何),均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料与信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与原始资料或原件一致,是准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人经合法授权并有效签署该等文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、在参与本次交易期间,本企业将依照相关法律、法规、规章的规定,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求,及时披露、提供相关信息和文件,并保证该等信息和文件的真实性、准确性和完整性,并保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、如果本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本企业同意不转让通过本次交易直接或间接取得的上市公司股份,并将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如果本企业未在两个交易日内提交前述锁定申请的,本企业在此同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;如果上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息,本企业在此同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如果调查结论发现存在违法违规情节,本企业承诺自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

6、本企业知悉上述承诺可能导致的法律后果;本企业进一步作出承诺,如果违反上述承诺,本企业愿意承担相应法律责任。

### 释义

在本预案中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 一、一般名词释义 | | |
| 预案/本预案/重组预案 | 指 | 《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 重组报告书/草案 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后,就本次交易编制的重组报告书 |
| 华天科技/公司/本公司/上市公司 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 华羿微电/标的公司 | 指 | 华羿微电子股份有限公司 |
| 标的资产/交易标的/拟购买资产 | 指 | 华羿微电100%股份 |
| 本次交易/本次重组/本次发行 | 指 | 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股份,并募集配套资金 |
| 华天电子集团 | 指 | 天水华天电子集团股份有限公司 |
| 肖胜利、肖智成 | 指 | 肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文强、周永寿、薛猛鑫、陈建军、崔卫兵、杨丽进、乔少华、张兴安13名自然人,系上市公司及标的公司实际控制人 |
| 西安后羿投资、后羿投资 | 指 | 西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 芯天钰铂 | 指 | 西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 陕西纾民基金 | 指 | 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙) |
| 南京飞桥 | 指 | 南京飞桥微电子有限公司 |
| 芯天金铂 | 指 | 西安芯天金铂企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 聚源绍兴基金 | 指 | 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) |
| 扬州齐芯 | 指 | 扬州齐芯眼方五号股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 甘肃兴陇 | 指 | 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 |
| 江苏盛宇 | 指 | 江苏盛宇华天创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 嘉兴兴雁 | 指 | 嘉兴兴雁投资合伙企业(有限合伙) |
| 昆山启村 | 指 | 昆山启村投资中心(有限合伙) |
| 南京盛宇 | 指 | 南京盛宇鸿鹄创业投资管理中心(有限合伙) |
| 嘉兴聚力 | 指 | 嘉兴聚力赋业荣号股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 无锡一村 | 指 | 无锡一村肇耕投资合伙企业(有限合伙) |
| 上海超越 | 指 | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 中诚投资 | 指 | 中信证券投资有限公司 |
| 小米产业基金 | 指 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) |
| 西高投 | 指 | 西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 陕西投改基金 | 指 | 陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 嘉兴根诚 | 指 | 嘉兴根诚创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 青岛万桥 | 指 | 青岛万桥冷链股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 金华金开 | 指 | 金华金开赣江联信华方贰号投资中心(有限合伙) |
| 陕西兴航成 | 指 | 陕西兴航成投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 上海创丰 | 指 | 上海创丰昕文创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 上海同禧 | 指 | 上海同禧企业管理中心(有限合伙) |
| 理想万盛 | 指 | 北京理想万盛投资管理中心(有限合伙) |
| 交易对方 | 指 | 华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂、陕西纾民基金、南京飞桥、芯天金铂、聚源绍兴基金、扬州齐芯、甘肃兴陇、江苏盛宇、嘉兴兴雁、昆山启村、南京盛宇、嘉兴聚力、无锡一村、上海超越、中诚投资、小米产业基金、西高投、陕西投改基金、嘉兴根诚、青岛万桥、金华金开、陕西兴航成、上海创丰、上海同禧、理想万盛 |
| 各方/交易各方 | 指 | 上市公司、交易对方、标的公司 |
| 双方/交易双方 | 指 | 上市公司、交易对方 |
| 发行股份购买资产定价基准日 | 指 | 上市公司第八届董事会第七次会议决议公告日 |
| 英飞凌 | 指 | Infineon Technologies AG,1999年成立,是全球领先的半导体公司之一 |
| 安森美 | 指 | ON Semiconductor Corporation,1999年从摩托罗拉分拆出来,是应用于高能效电子产品的高性能硅方案供应商,美国纳斯达克上市 |
| 意法半导体 | 指 | ST Microelectronics N.V.,1987年成立,由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成,纽约证券交易所、泛欧巴黎证券交易所和意大利米兰证券交易所上市 |
| 东微半导体 | 指 | 苏州东微半导体股份有限公司(688261.SH) |
| 华微电子 | 指 | 吉林华微电子股份有限公司(600360.SH) |
| 士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司(600460.SH) |
| 英诺赛科 | 指 | 英诺赛科(苏州)科技股份有限公司(2577.HK),是第三代半导体氮化镓芯片龙头企业 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司(002594.SZ),全球新能源汽车行业先行者和领导者 |
| 大疆 | 指 | 深圳市大疆创新科技有限公司,全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 |
| WSTS | 指 | 世界半导体贸易组织 |
| H3C | 指 | 新华三集团,数字化解决方案领导者,紫光集团旗下核心企业 |
| TTI | 指 | 创科集团,世界电动工具龙头企业 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所/交易所/证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《监管指引第7号》 | 指 | 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 |
| 《监管指引第8号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》 |
| 《公司章程》 | 指 | 天水华天科技股份有限公司章程 |
| GP | 指 | 普通合伙人 |
| LP | 指 | 有限合伙人 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 二、专业名词或术语释义 | | |
| 半导体 | 指 | 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见的半导体材料有硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓等。硅是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种 |
| 集成电路、IC | 指 | 一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构 |
| 半导体分立器件、分立器件 | 指 | 半导体分立器件,与集成电路相对而言的,采用特殊的半导体制备工艺,实现特定单一功能的半导体器件,且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现电度较大、成本较高。分立器件主要包括功率器件及小信号器件 |
| 半导体功率器件、功率器件、功率分立器件 | 指 | 又称电力电子功率器件,主要用于电力设备的电能变换和控制,是进行电能(功率)处理的核心器件,通电控制和强电运行间的桥梁。半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分,主要包括功率二极管、功率三极管、品闸管、MOSFET、IGBT等 |
| 晶圆 | 指 | 多指单晶硅圆片,由普通硅沙经制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为4寸、5寸、6寸、8寸等规格,近来发展出12寸甚至更大规格。在晶圆片上通过半导体加工工艺、加工制作成各种集成电路或分立器件,而成为有特定电性功能的半导体产品 |
| MOSFET、功率MOSFET、MOS管 | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物场效应晶体管,属于电压控制型器件,目前已广泛用于在电力电子电路中,也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能 |
| 沟槽型MOSFET、沟槽型功率MOSFET、Trench MOSFET | 指 | MOSFET栅极结构通过沟槽工艺制备,具有高元胞密度、低导通损耗等特点 |
| 屏蔽栅MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET、屏蔽栅极沟槽MOSFET、SGT MOSFET、Shield Gate MOSFET、Split Gate MOSFET | 指 | 基于全球先进的电荷平衡技术理论,打破了普通MOSFET的"硅限",具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点。目前主要用于高端电源管理、电机驱动、汽车电子等领域 |
| IGBT、IGBT器件 | 指 | Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写,绝缘栅双极型晶体管,同时具备MOSFET和双极性晶体管的优点,如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点,适用于600V-6500V高压大电流领域 |
| 二极管 | 指 | 一种具有正向导通、反向截止功能特性的半导体功率器件 |
| 三极管 | 指 | 全称为半导体三极管,包括双极晶体管、场效应晶体管等,是一种具有电流放大作用的半导体器件 |
| IPM、智能功率模块、模块 | 指 | Intelligent Power Module的缩写,智能功率模块,一种将功率器件和驱动电路等集成在一起的半导体模块 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacture的缩写,又称垂直整合模式,指半导体行业集产品设计、晶圆制造、封装测试、销售服务一体化整合的垂直运作模式 |
| BGA | 指 | Ball Grid Array的缩写,球栅阵列封装 |
| Bumping | 指 | 芯片上制作凸点 |
| DIP | 指 | Dual In-line Package的缩写,双列直插式封装 |
| DFN | 指 | Dual Flat No-lead的缩写,双边扁平无引脚封装 |
| ETSSOP | 指 | Exploded Thin Shrink Small Outline Package的缩写,外露载体薄的紧缩型小外形表面封装 |
| Fan-Out | 指 | 扇出型封装 |
| FC | 指 | Flip Chip的缩写,倒装芯片 |
| LGA | 指 | Land Grid Array的缩写,触点阵列封装 |
| LQFP | 指 | Low profile Quad Flat Package的缩写,薄型四边引线扁平封装 |
| MCM | 指 | Multi-Chip Module的缩写,多芯片组件封装 |
| MCP | 指 | Multi-Chip Package的缩写,多芯片封装 |
| MEMS | 指 | Micro-Electro-Mechanical Systems的缩写,微机电系统 |
| QFN | 指 | Quad Flat Non-leaded Package的缩写,方型扁平无引脚封装 |
| QFP | 指 | Quad Flat Package的缩写,四边引线扁平封装 |
| SDIP | 指 | Shrink Dual In-line Package的缩写,小间距双列直插式封装 |
| SiP | 指 | System in Package的缩写,系统级封装 |
| SOT | 指 | Small Out-line Transistor的缩写,小外形晶体管封装 |
| SOP | 指 | Small Out-line Package的缩写,小外形表面封装 |
| SSOP | 指 | Shrink Small Out-line Package的缩写,紧缩型小外型表面封装 |
| TSSOP | 指 | Thin Shrink Small Out-line Package的缩写,薄的紧缩型小外形表面封装 |
| TSV | 指 | Through-Silicon Via的缩写,直通硅晶穿孔封装,即硅通孔封装 |
| TQFP | 指 | Thin Quad Flat Package的缩写,薄塑料四角扁平封装 |
| WLP | 指 | Wafer Level Packaging的缩写,晶圆级封装 |

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;(2)本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于数据四舍五入造成的。

### 重大事项提示

截至本预案签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在本次交易的重组报告书中披露。最终审计、评估结果可能与本预案相关数据存在一定差异,提请投资者注意。

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概况

(一)本次交易方案概况

本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方购买标的公司华羿微电100%股份,并募集配套资金。

华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业,拥有兼具国际半导体功率器件设计经验与核心封装测试技术研发能力的研发团队,建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托,以终端应用技术为支撑的器件一体化设计及生产能力,具有突出的体系化竞争优势。

华羿微电采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略,根据陕西省半导体行业协会统计,华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位。其中,设计业务专注于以SGT MOS、Trench MOS为代表的高性能功率器件,客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等,覆盖汽车、服务器、新能源等高增长领域;封测代工业务产品可靠性高、一致性好、稳定性强,积极服务英飞凌、意法半导体、安森美、东微半导体、华微电子、士兰微、英诺赛科等国际国内知名半导体企业,得到了客户的广泛认可,2024年封测业务收入中占比约40%的产品质量等级满足工业及汽车级标准。业绩方面,2025年以来华羿微电季度利润持续增长,其中2025年三季度实现净利润预计超过3,000万元,环比增长超80%。结合有效的降本措施、产能利用率持续上升、稳定的客户合作关系及需求情况,华羿微电业绩情况预计持续向好。

本次交易前,上市公司聚焦集成电路封装测试业务,封测业务规模位列中国大陆前三、全球第六,在集成电路封装测试领域积累了较强的领先优势,并持续布局集成电路先进封装技术和产能。本次交易通过并购整合华羿微电,一方面上市公司能够快速完善封装测试主业布局,拓展功率器件封装测试业务,形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局,为客户提供更全面的封装测试产品,另一方面上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务,覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品,开辟第二增长曲线,实现新的收入增长点,进一步提高核心竞争力。本次交易将有助于上市公司及华羿微电最大化实现客户资源价值,双方客户结构上具有关联性及协同性,满足客户一揽子需求,为客户提供更全面的产品和服务,增强客户粘性。通过本次交易,上市公司收购优质标的资产,有助于优化上市公司产业布局,提高上市公司核心竞争力。

本次交易方案具体如下:

| | | |
|---|---|---|
| 交易形式 | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 |
| 交易方案简介 | | 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电100%股份。同时,上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 |
| 交易价格 | | 截至本预案签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。 |
| 交易标的 | 名称 | 华羿微电100%股份 |
| | 主营业务 | 高性能功率器件研发、设计、封装测试、销售 |
| | 所属行业 | 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),标的公司行业属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"C3972半导体分立器件制造"。 |
| | 其他 | 符合板块定位 | □是 □否 √不适用 |
| | | 属于上市公司的同行业或上下游 | √是 □否 |
| | | 与上市公司主营业务具有协同效应 | √是 □否 |
| 交易性质 | | 构成关联交易 | √是 □否 |
| | | 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 | □是 √否(预计) |
| | | 构成重组上市 | □是 √否(预计) |
| 本次交易有无业绩补偿承诺 | | | □有 □无(截至本预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商是否设置业绩补偿承诺及具体安排) |
| 本次交易有无减值补偿承诺 | | | □有 □无(截至本预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商是否设置减值补偿承诺及具体安排) |
| 其他需特别说明的事项 | | | 无 |

(二)标的资产评估作价情况

| 标的资产 | 基准日 | 评估或估值方法 | 评估或估值结果 | 增值率/溢价率 | 本次拟交易的权益比例 | 交易价格 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华羿微电100%股份 | 截至本预案签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。 | | | | | | |

(三)本次重组支付方式

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华羿微电100%股份。

(四)股份发行情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 境内人民币普通股(A股) | 每股面值 | 1.00元 |
| 定价基准日 | 上市公司第八届董事会第七次会议决议公告日 | 发行价格 | 8.35元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价的80% |
| 发行数量 | 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份的数量之和,其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价÷本次发行股票的每股发行价格。向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位,不足一股的部分计入上市公司的资本公积金(舍尾取整)。<br>本次发行的发行数量以买卖双方确认并经上市公司股东大会审议通过、经中国证监会同意注册的股数为准。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则将根据发行价格的调整,对发行数量作相应调整。 | | |
| 是否设置发行价格调整方案 | □是 √否(在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,上述发行股份数量将根据中国证监会及深交所颁布的规则作相应调整) | | |
| 锁定期安排 | 华天电子集团通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让;在本次交易实施完毕前已持有的上市公司股份,自本次交易实施完毕之日起18个月内不得转让,但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。<br>西安后羿投资通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让。<br>其他交易对方通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至其名下之日起12个月内不得上市交易或转让。但是,若取得新增股份时,交易对方对用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若其他交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时已满48个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。<br>本次交易完成后,股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | | |

二、募集配套资金情况

(一)募集配套资金概况

| | |
|---|---|
| 募集配套资金金额 | 上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,配套募资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%,最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会注册的数量为限。 |
| 发行方式 | 向特定对象发行 |
| 发行对象 | 不超过35名符合条件的特定对象 |
| 募集配套资金用途 | 本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中披露。<br>在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。 |

(二)募集配套资金的具体情况

| 股票种类 | 境内人民币普通股(A股) | | 每股面值 | 1.00元 |
|---|---|---|---|---|
| 定价基准日 | 本次募集配套资金的发行期首日 | | 发行价格 | 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。<br>最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及投资者申购报价情况确定。 |
| 发行数量 | 上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%,最终发行数量以经中国证监会注册后实际发行数量为上限。<br>本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股,则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将深交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。 | | | |
| 锁定期安排 | 本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因送股、送转、资本公积金转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | | | |

三、本次交易的性质

(一)本次交易预计不构成重大资产重组

截至本预案签署日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产经审计的财务数据及交易定价尚未确定。

本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易对方包含华天电子集团、西安后羿投资。华天电子集团系上市公司的控股股东,西安后羿投资的执行事务合伙人系上市公司实际控制人之一肖智成,均为上市公司的关联方。因此,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内,公司实际控制权未发生变更。本次交易前后,公司控股股东、实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前,上市公司主要聚焦集成电路封装测试业务,现已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、PLP、3D等集成电路先进封装技术,并承担了多项国家重大科技专项项目或课题。上市公司在封装测试领域的业务规模位列中国大陆前三、全球第六,已在集成电路封装测试领域积累了较强的领先优势。

标的公司是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业,拥有兼具国际半导体功率器件设计经验与核心封装测试技术研发能力的研发团队,建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托,以终端应用技术为支撑的器件一体化设计及生产能力,具有突出的体系化竞争优势。

标的公司采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略,根据陕西省半导体行业协会统计,标的公司2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位。其中,设计业务专注于以SGT MOS、Trench MOS为代表的高性能功率器件,客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等,覆盖汽车、服务器、新能源等高增长领域;封测代工业务产品可靠性高、一致性好、稳定性强,积极服务英飞凌、意法半导体、安森美、东微半导体、华微电子、士兰微、英诺赛科等国际国内知名半导体企业,得到了客户的广泛认可,2024年封测业务收入占比约40%的产品质量等级满足工业及汽车级标准。业绩方面,2025年以来标的公司季度利润持续增长,其中2025年三季度实现净利润预计超过3,000万元,环比增长超80%。结合有效的降本措施、产能利用率持续上升、稳定的客户合作关系及需求情况,标的公司业绩情况预计持续向好。

本次交易通过并购整合优质标的,一方面上市公司能够快速完善封装测试主业布局,拓展功率器件封装测试业务,形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局,为客户提供更全面的封装测试产品,另一方面上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务,覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品,开辟第二增长曲线,实现新的收入增长点,进一步提高核心竞争力。本次交易将有助于上市公司及标的公司最大化实现客户资源价值,双方客户结构上具有关联性及协同性,满足客户一揽子需求,为客户提供更全面的产品和服务,增强客户粘性。通过本次交易,上市公司收购优质标的资产,有助于优化上市公司产业布局,提高上市公司核心竞争力。

本次交易完成后,上市公司与标的公司将进行深度融合和协同,标的公司将纳入上市公司合并报表范围,有利于上市公司进一步扩大业务规模,实现上市公司战略目标。本次交易的实施符合国家新质生产力发展方向,能够有效提升上市公司核心竞争力和盈利能力,符合上市公司和全体股东的利益。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前,华天电子集团为上市公司控股股东,肖胜利、肖智成等13名自然人为上市公司实际控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。此外,本次交易不会导致公司股权分布不符合上市条件。

截至本预案签署日,本次交易对价尚未确定,上市公司发行股份的具体情况尚未确定,本次交易前后上市公司股权结构具体变动情况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会,并在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后,标的公司将成为上市公司合并报表范围内的子公司,上市公司的合并报表范围内总资产、净资产、收入、净利润等主要财务指标预计将实现增长,有利于增强上市公司持续经营能力。截至本预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易前后上市公司主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后,就本次交易对上市公司主要财务指标的影响分析在重组报告书中予以披露。

五、本次交易已履行及尚需履行的程序

(一)本次交易已履行的程序

截至本预案签署日,本次交易已履行的决策程序及批准包括:

1、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准;

2、本次交易已取得上市公司控股股东的原则性意见;

3、本次交易预案已经上市公司第八届董事会第七次会议审议通过。

(二)本次交易尚需履行的程序

截至本预案签署日,本次交易尚需履行的决策程序及批准包括:

1、本次交易的标的公司审计、评估工作完成后,上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案;

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

3、本次交易对方履行正式方案的内部授权或批准;

4、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册;

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性,最终取得批准或核准的时间也存在不确定性。

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见,以及相关方减持计划

(一)上市公司控股股东关于本次交易的原则性意见

上市公司控股股东已出具相关意见,原则性同意本次交易。

(二)上市公司控股股东及其相关方自首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员已出具《关于无减持计划的承诺函》,承诺自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕的期间内,其均不存在减持承诺方所持上市公司股份的计划,亦不会减持其所持有的上市公司股份。具体详见本预案"第一节 本次交易概述"之"九、本次交易各方作出的重要承诺"。

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排

(一)严格履行上市公司信息披露义务

在本次交易中,公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施,及时、完整地披露相关信息,切实履行法定的信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件及本次交易的进展情况。本次预案披露后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

(二)确保本次交易的定价公平、公允

上市公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估,确保本次交易的定价公允、公平、合理,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益。

(三)股东大会表决情况

根据《重组管理办法》的有关规定,本次交易涉及的关联交易议案需经上市公司股东大会作出决议,且必须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外,公司将对其他股东的投票情况进行单独统计并予以披露。

(四)严格执行关联交易审批程序

本次交易构成关联交易,上市公司将严格执行法律法规以及上市公司内部对于关联交易的审批程序。公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。在董事会审议本次交易相关议案时,由非关联董事表决通过,相关议案在提交董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议,并发表了同意的审核意见;相关议案提请股东大会审议时,关联股东将回避表决。

本次交易涉及的董事会、股东大会等决策程序,公司将遵循公开、公平、公正的原则,严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批程序。

(五)提供股东大会网络投票平台

根据《重组管理办法》的有关规定,本次交易涉及的关联交易议案需经上市公司股东大会作出决议,且必须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。根据中国证监会相关规定,为参加股东大会的股东提供便利,公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台,股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东外,其他股东的投票情况将单独统计并予以披露。

八、待补充披露的信息提示

本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成,本预案中涉及的财